



**boschman**  
advanced packaging technology

**烧结工具解决方案**



# 烧结解决方案

## 独特灵活性和最大控制力

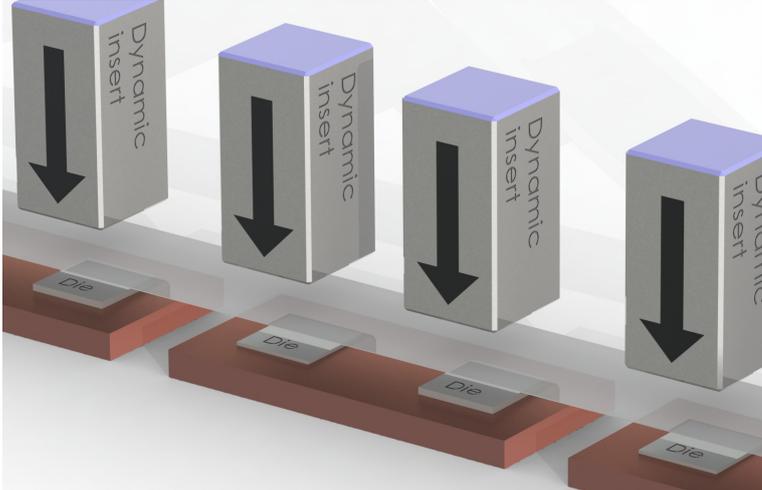


基于银膜工艺与形式（银膏、薄膜及其它）和自动化思想的不同应用，银烧结设备与模具市场中存在众多的设计和布局、各种各样的产品与芯片尺寸，以及多样化的工艺要求。因此，客户需要量身定制的银烧结模、治具解决方案。Boschman 可针对所有烧结系统提供各种烧结模、治具解决方案。

我们的核心技术是动态压头技术（已获专利）。在整个烧结工艺期间精确地控制和监测烧结压力。通过 MMI（人机界面）程控烧结压力。动态受控的压头可自动补偿芯片高度差，产生受控且可预测的烧结力，从而获得非常一致的键合线厚度 (BLT)。

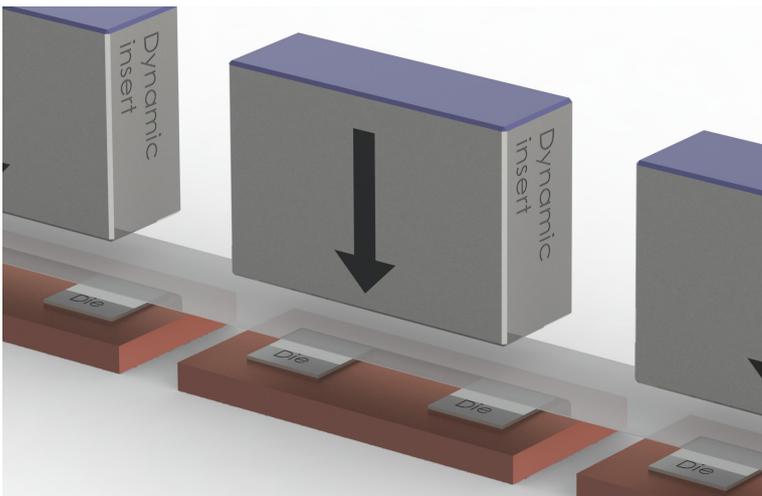


## 动态压头技术



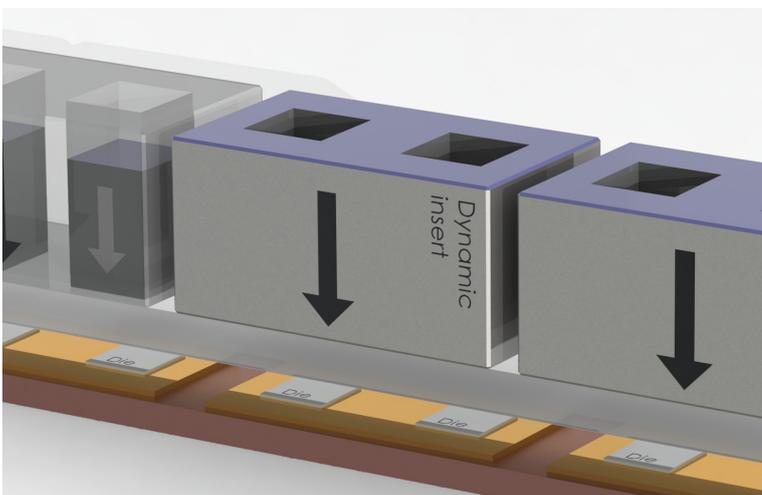
### 独立动态压头技术：

每个压头压制在单个芯片上。非常适合具有不同芯片高度的模块。



### 批量动态压头技术：

每个压头压制在多个芯片上。非常适合具有高度相同的芯片的模块。

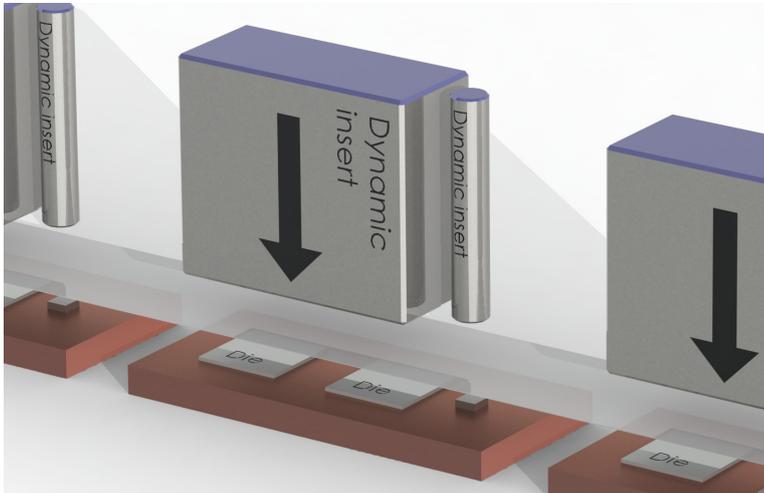


### 压头中压头动态压头技术：

在一次烧结周期中，我们可以烧结多个区域和层级。例如，芯片到 DBC、DBC 到散热器。

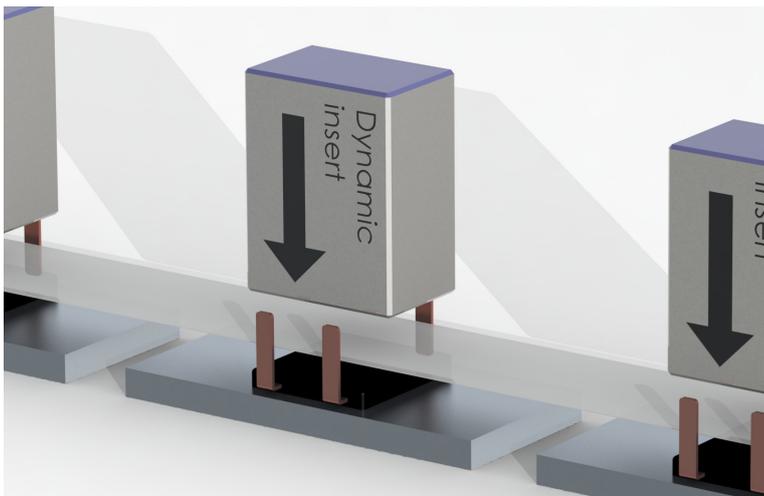


## 动态压头技术



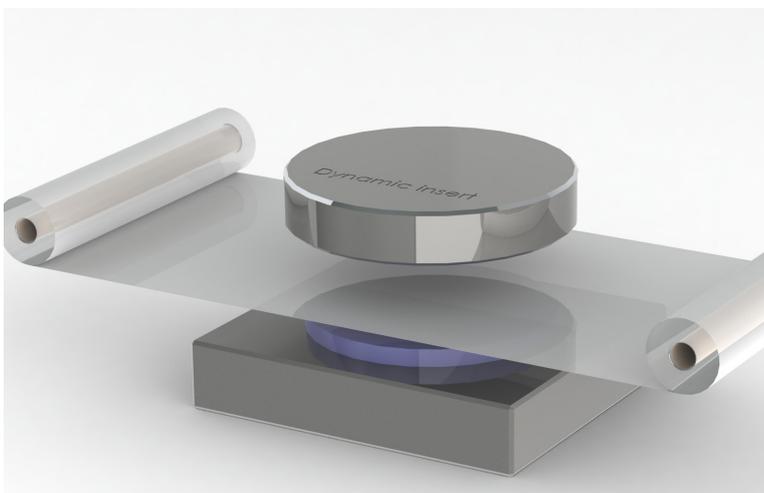
### 批量与独立动态压头技术结合：

即需要在一个周期中将热敏电阻与 GBT/FRD 芯片烧结在一起。



### 使用独立动态压头技术将封装件烧结到散热器：

通过精确的压力控制将每个压头压制到单个封装件上。

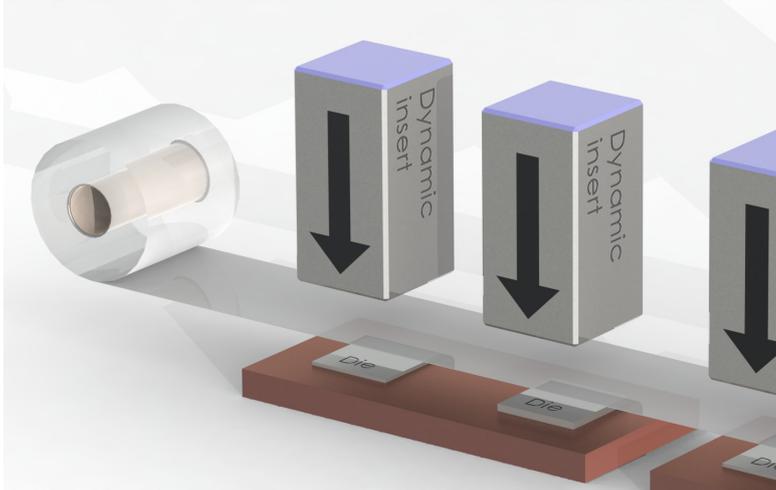


### 平模烧结：

适用于不存在多个不同高度的大面积烧结（即晶片和晶闸管）。

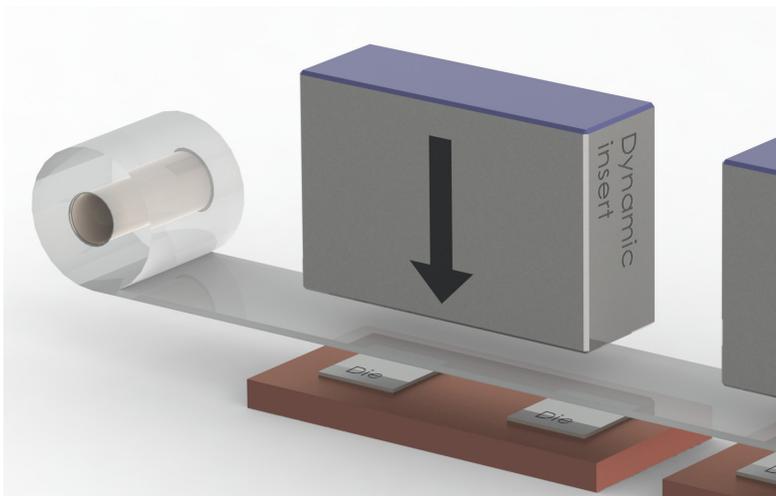


## 薄膜处理配置



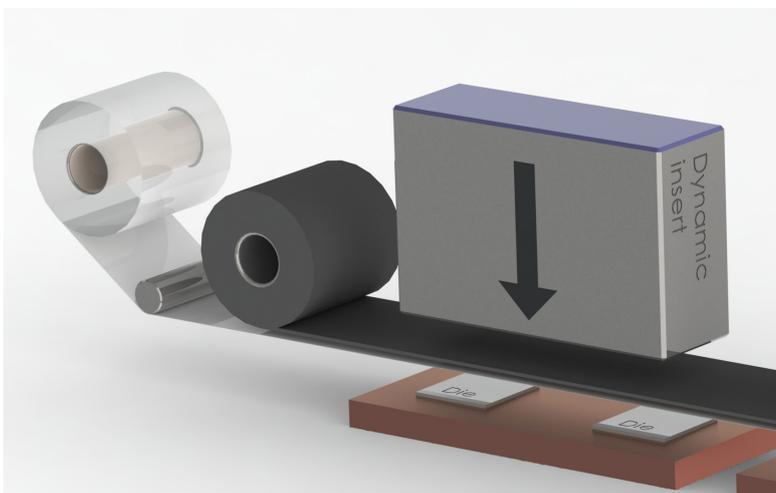
### 标准膜配置：

我们在压头和芯片之间使用标准的 50 um 保护膜。



### 厚膜配置：

我们可以使用厚达 300 um 的保护膜，同时还能均衡芯片高度差较小的芯片上的压力。



### 双膜配置：

双膜处理。可以结合保护层处理厚补偿层。

“尺寸更小、性能更好、成本更低，  
为您的产品提供最好的封装！”



package  
development



assembly  
services



equipment

**Boschman** | 先进封装技术

Stenograaf 3 6921 EX Duiven 电话 +31 26 319 4900 电子邮箱 info@boschman.nl

[www.boschman.nl](http://www.boschman.nl)